

# 科研衬底晶圆激光划片实验室单晶硅激光打孔微孔小孔加工

产品名称	科研衬底晶圆激光划片实验室单晶硅激光打孔微孔小孔加工
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

## 产品详情

华诺硅片激光切割机采用高性能激光器，激光切割热影响区小至10 μm，高速扫描振镜，精度高，寿命长。适用于PCB切割，FPC切割，覆盖膜切割，硅片切割，玻璃切割/划线/毛化，PET膜切割，PI膜切割，铜箔等超薄金属切割，碳纤维，石墨烯，高分子材料，复合材料切割。

华诺激光专注于微米级的激光精密切割、钻孔、刻线、划片、材料去除、构造、雕刻和特殊材料的打标，主要应用于LED芯片制造，触摸屏，LCD，消费类电子，半导体，MEMS，照明，医疗等行业，以及科研、航天航空、军事等领域，涉及包括各种金属及合金、半导体、陶瓷、各种透明材质、薄膜和聚合物等各种材料，公司已经做过1000多个基于以上材料的各种激光微加工试验和方案。